

# 中国国际金融股份有限公司

## 关于合肥晶合集成电路股份有限公司

### 2023 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“公司”）持续督导工作的保荐人，针对晶合集成 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日（以下简称“报告期”）经营情况，出具本持续督导半年度跟踪报告。

#### 一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐人已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐人已与晶合集成签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2023 年上半年度晶合集成在持续督导期间未发生按有关规定需保荐人公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2023 年上半年度晶合集成在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等情况。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐人通过日常沟通、定期或不定期回访等方式了解晶合集成业务情况，对晶合集成开展了持续督导工作。

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	2023 年上半年度，保荐人督导晶合集成及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐人督促晶合集成依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐人对晶合集成的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，晶合集成的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐人督促晶合集成依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐人对晶合集成的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2023 年上半年度持续督导期间内，晶合集成及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项。
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	2023 年上半年度持续督导期间内，晶合集成及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2023 年上半年度持续督导期间内，经保荐人核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。

序号	工作内容	持续督导情况
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	2023 年上半年度持续督导期间内，晶合集成未发生左述情况。
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐人已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
16	上市公司出现下列情形之一的，保荐人、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐人认为应当进行现场核查的其他事项。	本持续督导期间，晶合集成不存在需要专项现场检查的情形。

## 二、保荐人和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

## 三、重大风险事项

公司目前面临的主要风险因素如下：

### （一）核心竞争力风险

#### 1. 技术迭代风险

公司所处的晶圆代工行业技术更新迭代快，研发周期长，产品更新换代迅速，市场需求变化较快。为确保公司市场占有率及满足客户变动的需求，公司始终坚持技术创新的多元化路线，加大研发投入确保技术的先进性，重视自身知识产权体系的建立。

然而由于国内外市场及政策的多样性和未知性，以及不断加大的行业竞争，如不能及时根据市场需求开发相应的特色工艺平台，未能及时满足客户变动的需求，均有可能导致公司无法快速适应及应对，从而导致技术落后于竞争公司或行业水平,进而对公司的持续盈利能力产生影响。

## 2. 研发人员不足或流失风险

项目技术研发涉及多学科交叉，生产工艺流程复杂，对研发人员专业程度、经验水平平均有较高要求。然而近年来，我国集成电路行业发展迅速，但相关人才储备仍有缺口、人员专业程度存在不足。集成电路行业人才争夺较为激烈、人员流动较为频繁。如公司无法持续吸引人才及扩充研发团队，或无法留住研发人员并保持研发团队的稳定性，将对公司的技术研发及生产经营造成不利影响。

### (二) 经营风险

#### 1. 经营业绩下滑的风险

报告期内，公司实现营业收入为 296,966.59 万元，较去年同期减少 50.44%。公司二季度经营业绩较一季度已有所提升，但不排除未来受市场规模变化、行业竞争加剧、产品更新换代等因素综合影响，下游市场需求可能发生波动。如果公司未能及时应对上述市场变化，将面临经营业绩下滑的风险。

#### 2. 与行业领先企业相比，在技术水平、业务规模、盈利能力等方面存在较大差距的风险

技术水平方面，公司专注于 12 英寸晶圆代工业务，已实现 150nm-55nm 制程节点量产，正在进行 40nm、28nm 制程技术平台的开发工作。但台积电、联华电子、中芯国际等全球行业领先企业已达 5nm、14nm 等制程节点，公司与之存在较大差距。

业务规模和盈利能力方面，报告期内毛利率、业务规模和市场占有率低于台积电、联华电子等行业领先企业，公司在业务规模和盈利能力等方面与行业领先企业存在较大差距。

如果公司无法在未来持续推动技术进步，丰富产品结构、拓展客户、提高业务规模和市场占有率、增强盈利能力，将可能难以缩短与行业领先企业的差距，在激烈的市场竞争中受到不利影响。

#### 3. 产品应用领域单一，业务拓展面临技术风险

公司主要从事 12 英寸晶圆代工业务，主要向客户提供 DDIC 及其他工艺平台的晶圆代工服务。目前公司产品应用领域主要为面板显示驱动芯片领域。如公司在面板显

示驱动芯片领域客户订单流失或议价能力下降，且未能及时完成 CIS、MCU 的扩产和 PMIC 等其他技术平台的研发及量产工作，无法在短时间内形成多元化的产品应用领域结构，或先进制程节点研发进度滞后，则可能对公司的经营业绩造成不利影响。

#### **4. 客户集中度较高的风险**

报告期内，公司前五大客户的销售收入合计 197,402.94 万元，占营业收入的比例为 66.47%，客户集中度较高。公司目前与主要客户维持了长期业务往来关系并与部分客户签署了长期框架协议，如果公司的主要客户生产经营出现问题，导致其向公司下达的订单数量下降，则可能对公司的业绩稳定性产生影响，将可能对公司经营业绩产生不利影响。

### **(三) 财务风险**

#### **1. 存货跌价风险**

报告期末，公司的存货账面价值为 126,079.94 万元，占总资产比例为 2.62%。

报告期末，公司的存货跌价准备金额为 22,097.47 万元，对应存货期末余额的计提比例为 14.91%，较 2022 年末存货跌价准备对应存货期末余额计提比例 24.25% 已有所下降。公司存货跌价准备的计提主要系公司产能利用率下降，同时由于设备等生产性长期资产投入大，单位产品承担较大的折旧、摊销导致单位产品生产成本高于可变现净值，进而计提较多存货跌价准备。如果未来公司的产能利用未达预期，可能持续存在存货跌价风险。

#### **2. 固定资产投资风险**

晶圆代工行业属于典型的资本密集型行业，固定资产投资的需求较高、设备购置成本高。公司近年为紧抓行业发展机遇积极进行产能扩充，固定资产投资规模较大。若公司未来收入规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，公司将面临盈利能力下降的风险。

#### **3. 汇率波动风险**

公司的记账本位币为人民币，而部分交易采用美元、日元等外币计价。公司在经营过程中重视外币资产和外币负债在规模上的匹配，合理控制外汇风险敞口。但公司难以

预测市场、金融政策等因素未来可能对人民币与美元汇率产生的影响，该等情况可能导致人民币与美元汇率出现更大幅度的波动。未来若境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得本外币汇率大幅波动，公司将面临汇兑损失的风险，并可能影响公司的进出口成本、出口竞争力等。

#### **（四）行业风险**

##### **1. 行业竞争风险**

晶圆代工市场竞争激烈，公司与行业龙头相比存在一定的技术差距。随着物联网、人工智能和云计算等新应用领域的不断涌现，芯片产业发展的热点领域在不断丰富，广阔的市场前景及较为有利的产业政策吸引了诸多境内外集成电路相关企业布局集成电路晶圆代工行业，可能导致市场竞争进一步加剧。未来，如果公司无法及时开发和引进最新的制造工艺技术，或推出能够更好地满足客户需求的工艺平台，将削弱公司的竞争优势。

##### **2. 产业政策变化风险**

近年来，国务院推出了《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号）、《关于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》（国发〔2020〕8号）等多项产业政策，促进集成电路行业发展；我国各级政府亦为集成电路企业提供了相关政策支持，在财税、投融资、研究开发、人才、知识产权等方面给予一系列优惠措施，进一步加强信息产业的创新能力和国际竞争力。如未来上述产业政策出现不利变化，将对公司产生不利影响。

#### **（五）宏观环境风险**

##### **1. 宏观经济波动和行业周期性风险**

受到全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，集成电路行业存在一定的周期性。因此，集成电路行业的发展与宏观经济整体发展亦密切相关。如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，集成电路行业的市场需求也将随之受到影响；另外下游市场需求的波动和低迷亦会导致集成电路产品的需求下降，或由于半导体行业出现投资过热、重复建设的情况进而导致产能供应在景气度较低时超过市场需求，进而影响集成电路晶圆代工企业的盈利能力，将可能对公司的经营业绩造成一定的影响。

## 2. 国际贸易摩擦风险

公司使用的主要生产设备，硅片、设备零配件等主要原材料主要通过向境外企业采购取得。公司的部分主要客户亦为境外企业，未来，如出现贸易摩擦、国际政治、不可抗力等因素，将造成公司设备、原材料进口成本增加，产品境外销售利润率下降，对公司生产经营产生不利影响。

## 四、重大违规事项

2023 年上半年度持续督导期间内，晶合集成不存在重大违规事项。

## 五、主要财务指标的变动原因及合理性

2023 年上半年度，晶合集成主要财务数据及指标如下所示：

单位：万元

项目	2023年1-6月/本期期末	2022年1-6月/上年同期期末	本期比上年同期增减(%)
营业收入	296,966.59	599,158.31	-50.44
归属于上市公司股东的净利润	-4,361.02	262,867.89	-101.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-14,619.79	257,341.11	-105.68
经营活动产生的现金流量净额	-29,878.24	515,179.97	-105.80
归属于上市公司股东的净资产	2,283,766.84	1,312,415.66	74.01
总资产	4,817,016.64	3,876,457.45	24.26

2023 年上半年度，公司主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2023年1-6月	2022年1-6月	本期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元/股）	-0.03	1.75	-101.71
稀释每股收益（元/股）	-0.03	1.75	-101.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.09	1.71	-105.26
加权平均净资产收益率（%）	-0.27	24.28	减少24.55个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.89	23.77	减少24.66个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	16.92	6.58	增加10.34个百分点

营业收入较上年同期减少 302,191.72 万元，同比下降 50.44%，主要系半导体行业

景气度下滑，市场整体需求放缓所致。

归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 267,228.90 万元，同比下降 101.66%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 271,960.90 万元，同比下降 105.68%，主要系：（1）公司营业收入同比下降 50.44%，而公司折旧、摊销等固定成本较高；（2）公司持续增加研发投入，研发费用较上年同期增长 27.46%。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 105.80%，主要系受市场景气度影响，本期营业收入降低，销售商品、提供劳务收到的现金减少以及客户产能保证金到期返还所致。

归属于上市公司净资产较上年度末增加主要系公司首次公开发行股票收到募集资金，股本和资本公积相应增加所致。

## 六、核心竞争力的变化情况

### （一）研发团队经验丰富，技术实力行业领先

晶合集成已建立了完善、成熟的研发机制，囊括市场调研、可行性评估、技术研发、流片验证等核心环节，在敏锐洞悉市场需求的同时，提高研发效率、控制研发成本，实现了高效可靠的研发与商业应用。公司研发团队核心成员均由境内外资深专家组成，拥有在行业内多年的技术研发经验。

公司持续进行研发团队的建设与研发能力的提升。报告期内，公司研发投入 50,233.08 万元，占营业收入的比例为 16.92%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有 4,096 名员工，其中包括 1,438 名研发技术人员，占员工总数比例为 35.11%，其中硕士及以上占比约 60%。

### （二）产品结构不断丰富，工艺平台多元发展

晶合集成不断致力于丰富自身产品结构及强化自身技术能力。报告期内，公司已实现 DDIC、CIS、MCU、PMIC 等平台各品类产品量产，平台及产品结构日益丰富，产品应用涵盖消费电子、智能手机、智能家电、电源管理、安防、工控、车用电子等诸多领域，可为客户提供丰富的产品与系统解决方案。公司产品工艺制程已覆盖 150nm 到 55nm，同时 40nm-28nm 正在进行开发，技术能力稳步增强。



### **（三）位居合肥战略核心，服务广阔产业市场**

合肥市作为国家级科技创新型试点城市，制定了集成电路产业发展规划，并结合自身特色，提出了“芯屏汽合”的产业发展战略，已形成新型显示器件、集成电路、新能源汽车和人工智能等新兴产业，终端芯片需求旺盛。公司所处的半导体代工环节，为半导体产业链中最为重要的环节之一。公司充分发挥本地终端市场距离近、规模大的优势，依靠成熟的制程制造经验，配套服务于合肥产业链规划，提供关键芯片，促进产业链联动发展，是合肥市产业发展规划的重要组成部分。

### **（四）客户关系紧密持久，推动国产供应替代**

晶合集成客户群已覆盖国际一线客户，获得了众多境内外知名芯片设计公司和终端产品公司的认可，与越来越多的企业建立了长期合作关系。

公司在业界具有良好的口碑及供应商基础，最大程度地采用国产化设备与材料，推动中国大陆供应链国产替代。设备方面已成功导入如北京北方华创微电子装备有限公司、中微半导体设备(上海)股份有限公司、盛美半导体设备(上海)股份有限公司、北京屹唐半导体科技股份有限公司、拓荆科技股份有限公司等国产设备领先厂商，材料方面已完成如广东华特气体股份有限公司、广州广钢气体能源股份有限公司、上海超硅半导体股份有限公司、中环领先半导体材料有限公司、西安奕斯伟硅片技术有限公司等国产材料供应。

### **（五）体系认证齐全，质量稳定可靠**

晶合集成始终重视质量管理体系建设，截至目前,公司已取得质量管理体系认证 ISO9001，环境管理体系认证 ISO14001，职业健康安全管理体系认证 ISO45001，有害物质过程管理体系 QC080000，温室气体排放盘查认证 ISO14064 等诸多认证。此外，在车用芯片领域，公司也已取得车载质量管理体系 IATF16949 认证，公司 110nm 面板驱动芯片已完成汽车 12.8 英寸显示屏总成可靠性测试。

### **（六）智能制造，高效稳定，成本具有竞争力**

2020 年晶合集成智能生产线获得安徽省智能工厂认证，其高端智能制造营运管理制度及系统，涵盖数字化生产系统、自动化无人搬运系统、车间自动化控制系统、智能品质与设备监控系统、智能生产派工系统等，可为客户提供更优质代工服务及更稳定的

品质。

此外，公司持续深耕本地产业链配套，从原材料到整机产业链，可实现就近供应，使自身产品成本更具竞争力。

## 七、研发支出变化及研发进展

### （一）研发支出及变化情况

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	50,233.08	39,409.98	27.46
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	50,233.08	39,409.98	27.46
研发投入总额占营业收入比例	16.92%	6.58%	增加 10.34 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

### （二）研发进展

报告期内，公司研发进展顺利，针对关键研发重点、难点进行集中攻坚，取得了显著的成果，具体如下：

- 1、55nm 铜制程平台及 145nm 低功耗高速显示驱动平台开发完成；
- 2、公司自主研发的 55nm TDDI 产品已实现大规模量产；
- 3、公司 40nm 高压 OLED 平台取得重大成果，平台元件效能与良率已符合目标，具备向客户提供产品设计及流片的能力；
- 4、公司车用 110nm 显示驱动芯片在车规 CP 测试良率已达到良好标准，并于 2023 年 3 月完成 AEC-Q100 车规级认证，于 2023 年 5 月通过公司客户的汽车 12.8 英寸显示屏总成可靠性测试。

报告期内，公司新增发明专利共 114 项，实用新型专利 27 项，软件著作权 1 项。

## 八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

## 九、募集资金的使用情况及是否合规

### （一）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099 号）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	9,723,516,459.91
加：尚未支付的发行费用	6,283,373.78
加：前期已支付但尚未置换的发行费用	16,782,836.60
加：利息收入扣除银行手续费净额	18,870,185.85
减：募投项目支出（包括已完成置换的募投项目先期投入金额 <sup>1</sup> ）	1,463,713,179.23
截至2023年6月30日募集资金专户应有余额	8,301,739,676.91
截至2023年6月30日募集资金专户实际余额	8,301,595,337.29
差异	144,339.62

注 1：募投项目先期投入及置换情况详见公司披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

上述募集资金应有余额与募集资金实际余额之间的差异 144,339.62 元主要系公司于 2023 年 5 月 15 日误使用在中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行开立的募集资金存放专项账户支付了一笔发行费用（审计费）对应的增值税所致。截至本报告出具之日，公司已从自有资金账户中将前述 144,339.62 元归还至原募集资金存放专项账户。

公司于 2023 年 6 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币

2,075,224,554.41 元及已支付的发行费用的自筹资金人民币 16,782,836.60 元，金额共计人民币 2,092,007,391.01 元。具体内容详见公司于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-007）、《关于合肥晶合集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]230Z2088 号）。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 2,075,224,554.41 元，其中已完成 1,000,000,000.00 元募集资金置换，剩余 1,075,224,554.41 元尚未完成募集资金置换。截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金支付发行费用的金额为 16,782,836.60 元，该发行费用尚未完成置换。

公司于 2023 年 6 月 21 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币 50 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

报告期内，公司暂未使用闲置募集资金进行现金管理。

2023 年 6 月 21 日，公司第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 6,000 万元用于永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-008）。该事项需经股东大会审议通过后实施。

2023 年 6 月 21 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金等额置换。具体内容详见公司于

上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《合肥晶合集成电路股份有限公司关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-006）

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额
合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000057	743,588,380.03
中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	181267662902	1,288,467,076.67
中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行	12181001040035296	1,829,256,622.71
招商银行股份有限公司合肥分行	551904996610555	477,720,970.13
兴业银行合肥望江东路支行	499050100100419345	614,879,783.34
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129200389609	1,600,593,303.33
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002618	1,747,089,201.08
<b>合计</b>		<b>8,301,595,337.29</b>

## （二）募集资金合规情况

公司曾误使用 144,339.62 元募集资金支付发行费用（审计费）对应的增值税，所涉募集资金金额较小，未对募集资金投资项目进程产生不利影响，且公司现已从自有资金账户中将前述 144,339.62 元归还至原募集资金存放专项账户。

除前述情况外，公司 2023 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理办法》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

## 十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

截至 2023 年 6 月 30 日，晶合集成董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动

情况如下：

姓名	担任的职务	变动情形
邱显寰	营运资深副总经理	聘任
郑志成	研发资深副总经理	聘任
张伟瑾	N1厂协理	聘任
吴志楠	模组研发协理	聘任
黎翠绫	企划协理	聘任

上述人员变动情况详见公司《合肥晶合集成电路股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-011）

截至2023年6月30日，晶合集成现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份变动的情况如下：

姓名	职务	期初持股数 (股)	期末持股数 (股)	报告期内股份 增减变动量 (股)	增减变动原因
蔡国智	董事长	0	73,543	73,543	二级市场增持
蔡辉嘉	总经理	0	60,000	60,000	二级市场增持
朱才伟	董事、董事会秘书、财务 负责人、副总经理	0	260,931	260,931	二级市场增持
周义亮	副总经理	0	142,372	142,372	二级市场增持
郑志成	研发资深副总经理	0	10,000	10,000	二级市场增持

注：以上持股均为直接持股，不含间接持股。

截至2023年6月30日，晶合集成实际控制人和董事、监事、高级管理人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

## 十一、上海证券交易所或保荐人认为应当发表意见的其他事项

2023年1-6月，公司营业收入合计296,966.59万元，较上年同期下降50.44%；归属于母公司所有者的净利润-4,361.02万元，较上年同期下降101.66%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-14,619.79万元，较上年同期下降105.68%，公司较上年同期由盈转亏。

公司营业收入及净利润变动主要系集成电路行业周期波动影响，2022年1-6月集成

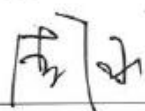
电路行业景气度升高，公司产品需求旺盛，2022年1-6月公司营业收入较上年同期增长达273.58%；2022年1-6月公司归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长达2058.17%。

本报告期内公司营业收入下降主要系2023年上半年，全球经济低迷，智能手机、笔记本电脑等消费电子市场下滑，供应链持续调整库存，导致全球晶圆代工企业面临不同程度的产能利用率下行及营收衰退，全球集成电路行业进入下行周期，且公司持续进行产线建设及研发投入，导致资产折旧、摊销金额及研发费用整体上升，上述因素叠加，导致公司利润水平较去年同期高景气度环境存在大幅降低。保荐人已在本报告之“三、重大风险事项”之“（二）经营风险”之“1. 经营业绩下滑的风险”对相关风险进行提示。

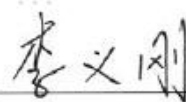
未来，保荐人将督促公司做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示经营风险，切实保护投资者利益，亦提醒投资者特别关注行业周期波动及市场环境变化带来的投资风险。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：



周 玉



李义刚

